

BSSOCKET をご使用の前に

1. 本製品は、システムでの開発、評価での使用を想定したものです。また国内の使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。
2. BSSOCKET は、振動及び衝撃環境にはご使用になれません。
3. 製品がケースに梱包されている場合は、ケースを 50 以上の場所に長時間放置すると変形する場合がありますので、40 以下の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
4. BSSOCKET はハンダボール表面の酸化を防ぐために真空パック梱包されております。開封後はなるべく当日中にハンダ付けをする事をお奨めします。翌日になる場合はデシケーター内で保管して下さい。
5. BSSOCKET は飛散フラックスの付着防止の為、嵌合部側表面に保護（ポリイミド）テープが貼ってあります。ハンダリフロー終了時までには保護テープを付けておいて下さい。
6. 推奨リフロー条件
BSSOCKET の表面温度（共晶ハンダの場合）
プリヒート : 150～180 、 180 秒程度
本加熱 : 210 以上、30 秒～60 秒程度
鉛フリーハンダの場合の本加熱温度：260 、 10 秒以内
7. 基板取り付け推奨フットパターン図は個別の製品図面をご参照願います。
8. BSSOCKET は、構造上フラックス及び洗浄液がソケット内に残る為、フラックスの浸漬、フラックス洗浄は絶対に行わないで下さい。又、他の DIP 部品との併用においてもソケット内に入る恐れがありますので、フラックス洗浄は行わないで下さい。
9. ガイドピン付きの BSSOCKET をハンダ付けする場合、補強のためにガイドピンを基板下側よりハンダ付けするか、ソケット周辺部を樹脂等で固定することをお奨めします。